# (54) FILM FOR OIL-IMPREGNATED CAPACITOR

(11) 4-138244 (A) (43) 12.5.1992 (19) JP

(21) Appl. No. 2-262698 (22) 28.9.1990

(71) TORAY IND INC (72) MEGUMI TANAKA(2)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. B29C55/12,B32B3/30,B32B27/32,H01G4/18,H01G4/22, H01G4/32//B29K23/00,B29L7/00,B29L9/00

PURPOSE: To improve sliding properties of a film, element winding properties and impregnation properties of insulating oil by providing a rough face with granular projections on the surface of a film and also providing a rough face of mesh structure on the other face.

CONSTITUTION: Both faces of a film are roughened, and one face is a rough face of mesh structure with 0.025 μm-0.15 μm surface roughness Ra and with 10 to 30 projections per mm of 0.0125 \mu m or over formed thereon, while the other face is provided with granular projections, and a film for an oil impregnat-. ed type capacitor of  $0.05\mu\text{m}$ - $0.3\mu\text{m}$  surface roughness Ra and with 10 to 40 projections per mm of  $0.025\mu m$  height formed thereon is formed. The film roughened on its both faces is composed, for example, of an ethylene propylene copolymer and can be manufactured by laminating a composite layer with independent granular projections on its surface and a base layer of polypropylene with mesh structure surface.

### (54) FORMING DEVICE FOR SOLID SHAPE

(43) 12.5.1992 (19) JP (11) 4-138245 (A)

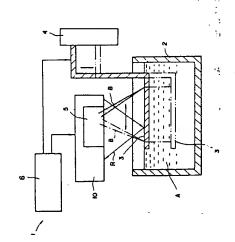
(21) Appl. No. 2-262178 (22) 29.9.1990

(71) SONY CORP (72) KAZUMINE ITOU

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. B29C67/00//B29C35/08,B29K105/24

PURPOSE: To offset correct the emission position of beam based on the sensing information by installing a sensing device for sensing strength of the beam or the strength distribution in the beam diameter direction.

CONSTITUTION: A sensing device 10 for sensing the strength in the beam diameter direction of laser or a profile equivalent to power, energy or the like (more concretely, an area sensor such as CCD or MOS, PSD or a pickup tube or the like) is installed. The emission position of beam B exposed to light is offset corrected by controlling a beam scanner 5 by means of a shape control 6 based on the information obtained by said sensing device 10. As for parameters for controlling the beam scanner at the time of drawing, laser power and drawing speed are applied mainly, and if how the setting beam width is varied to the variation of the parameters can be estimated numerically, accurate offset value can be computed. The beam scanner 5 for condensing and emitting the beam B exposed to light to the liquid level of a liquid photosetting type resin material A is installed above a storage tank 2.



# (54) PLATE-SHAPED FORMED BODY AND MANUFACTURE THEREOF

(11) 4-138246 (A) (43) 12.5.1992 (19) JP

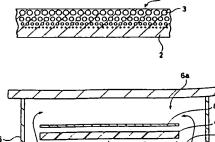
(21) Appl. No. 2-261115 (22) 29.9.1990

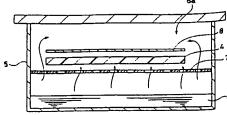
(71) SUMITOMO HEAVY IND LTD (72) YUJI ASHIBE(1)

(51) Int. Cl<sup>5</sup>. B29C67/22,B29B15/10,C08J9/14,C08J9/35//B29K105/04,B29L7/00

PURPOSE: To increase strengths such as deflection strength, other tension and the like of a foamed body by varying the expansion ratio correspondingly to the plate thickness direction from one foamed face of a plate-shaped foamed body to the other non-foamed face.

CONSTITUTION: A plate-shaped base resin 4 with a foamed agent impregnation prevention film 8 on the upper face or the lower face only is placed on a porous plate 7. When the plate-shaped base resin 4 is left in a foaming agent atmosphere gas 6a formed by the evaporation of a foaming agent 6 for several hours, the foaming agent 6 is impregnated with the plate-shaped base resin 4 starting its one face. Then, the foaming agent impregnation prevention film 8 is peeled off and a plate-shaped foaming body element 9 impregnated with the foaming agent 6 is thermoplasticized while the pressure is for preventing abnormal foaming or the like is applied by a hot press or the like to prepare a plate-shaped foamed body 1. The one face of the plate-shaped foamed body I thus prepared is in the non-foamed state, while the other face is in the foamed state, and the expansion ratio is varied successively in compliance with its plate thickness direction and the non-foamed side 2 is hardened and provided with strength, while the foamed side 3 is softened and provided with heat insulation properties, sound-absorption properties and impact absorption properties.





C(

(11

(21

(71

(51

7

() (; (; (;

# ⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許 出願公開

# @ 公開特許公報(A) 平4-138244

௵Int. Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	@公開	平成 4 年(199	2)5月12日
B 29 C 55/12 B 32 B 3/30 27/32	F.	7258-4F 6617-4F 8115-4F		.· ·	,
H 01 G 4/18 4/22 4/32	330 Č 301 B	7924-5E 7924-5E 7924-5E			• •
# B 29 K 23:00 B 29 L 7:00 9:00					(人《管》

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

〇発明の名称 油含浸型コンデンサ用フィルム

②特 顯 平2-262698

②出 願 平2(1990)9月28日

砂発明者田中 恵 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業場内砂発明者 土屋 勝洋 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業

場内

個発 明 者 小 谷 義 則 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社滋賀事業 場内

⑦出 顋 人 東 レ 株 式 会 社 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

#### 明細書

# 1 発明の名称

油含浸型コンデンサ用フィルム

# 2 特許請求の範囲

(1) 両面が粗面化されたフィルムであって、一方の面は網目構造よりなる粗面であり表面粗度 Raが 0. 0 2 5 μm~0. 1 5 μmであり高さ 0. 0 1 2 5 μm以上の突起が 1 0 個/mm~3 0 個/mm存在し、他方の面は独立した粒状突起が形成され表面粗度 Raが 0. 0 5 μm~0. 3 μmであり高さ 0. 0 2 5 μm以上の突起が 1 0 個/mm~4 0 個/mm存在することを特徴とする油含浸型コンデンサ用フィルム。

(2) エチレンプロピレン共重合体からなる複合層とポリプロピレンからなるベース層との積層構造を有することを特徴とする請求項1記載の油会漫型コンデンサ用フィルム。

### 3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は絶 油の含浸性を改良した油含浸型コ

ンデンサ用フィルムに関する。

〔従来の技術〕

一軸または二軸延伸されたポリプロピレンフィルムは電気特性が優れているため油含浸型コンデンサの誘電体層として使用されている(特開昭 5 1 - 6 3 5 0 0 号公報、特開昭 6 2 - 7 1 2 1 1 号公報等)。

### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、これら従来の技術には下記のような欠点があった。

すなわち、特開昭51~63500号公報に記載されたβ晶生成による網目構造を有する粗面フィルムはフィルム表面の凹凸が小さく、粗面密度が少なく、コンデンサ形成時のフィルム層間への油含浸が不充分であり、部分的に未含浸部分が生じ、コロナ破壊による早期絶縁破壊にいたりコンデンサ寿命を大幅に低下させる。

特開昭 62-71211 号公報に開示されたものは、独立した粒状突起で表面租度 R a が 0.2  $\mu$  m  $\sim 0.7$   $\mu$  m の フィルムであるが、 6  $\mu$  m  $\sim$ 

12μmの薄いフィルムでは表面粗れ状態が大きくなり過ぎているため、実厚みの低下により耐圧が劣り、コンデンサ寿命を低下させる。また、コンデンサ形成時の素子巻工程において、摩擦帯電による静電気が発生し、Α 1 箔との合わせ巻時敏を巻込み十分な素子を得ることができない。

本発明は上記従来の欠点を解消し、素子巻き加工時に優れ、かつ誘電体層の油層を十分に確保し、かつコンデンサ寿命の優れた誘電体層を有する油含浸型コンデンサ用フィルムを提供することを目的とするものである。

# [課題を解決するための手段]

本発明は、両面が粗面化されたフィルムであって、一方の面は網目構造よりなる粗面であり表面 粗度Raが0.  $025\mu$ m $\sim$ 0.  $15\mu$ mであり 高さ0.  $0125\mu$ m以上の突起が10個/mm  $\sim$ 30個/mm存在し、他方の面は独立した粒状 突起が形成され表面粗度Raが0.  $05\mu$ m $\sim$ 0.  $3\mu$ mであり高さ0.  $025\mu$ m以上の突起が10個/mm $\sim$ 40個/mm $\sigma$ 在することを特徴と

起が10個/mm~30個/mm存在することが必要であり、好ましくは15個/mm以上~25個/mm以下である。高さ0.0125μm以上の突起が10個/mmより少ないと粗面が不充分であり、滑り不良のため素子巻加工性に支障をきたす。また、30個/mmより多くなると、フィルム自体の耐電圧特性を低下させ、耐圧良好なコンデンサを得ることができなくなる。

本発明のフィルムの他方の面(以下「B面」という)は独立した粒状突起が形成され、その表しれ、好にはない。 0.00 0.

また B 面の突起数は、高さ 0. 025 μ m 以上

する油含浸型コンデンサ用フィルム、を要旨とす ス.

本発明の油含浸型コンデンサ用フィルムは、両面が粗面化されたフィルムであり、一方の面(以下「A面」という)は、網目構造よりなる粗面である。この網目構造は繊維状物、髪状物またはこれらの集合体からなる網目要素から構成されているものであり、数繊維状物および髪状物は網目状組織の結節点を構成しているものである。

A面の表面粗度 R a は 0 . 0 2 5 μ m ~ 0 . 1 5 μ m 、 9 ましくは 0 . 0 4 μ m ~ 0 . 1 0 μ m である。この範囲より R a が小さい場合には場合により A l は であり、 素子巻時には 1 であるの数面が平滑であり、 素子巻時に δ で の で な の 合 せ 巻き に A l 名に折れ 観いて 発って な は で な の は で す る。 ン サ の は で な の は で 下 や 観に よ が 見られるようになる。

またA面には、高さ0. 0125μm以上の突

の突起が10個/mm~40個/mm存在する30とが必要であり、好ましくは15個/mmの粒/mmル上の位/mmをも0.025μm以上不一の粒分のである。高さ0.025μmの粒/mmをもり少ないである。高さり少ななである。ないのである。のでは、40個/mmを越えると祖れの程度が多っている。の耐圧低下につながる。コールムをはいませる。ロールムをはいませる。ロールムをはいませる。ロールムをはいませんの個/mmをはいませんのです。ロールムをはいませんの個/mmをはいませんのである。

本発明の両面が粗面化されたフィルなはなまりつピレン共動合とのである。このであることを表示して得ることを表示を有いて得ることを表示を有いての表面は観光である。で、のであるとができる。で、のであるとができません。で、ので、ので、を発明の効果が進んない。で、のであれば他種オレフィンが共動合されまたは他種オレフィンが共動会であれば他種オレフィンを表明のが共動会であれば他種オレフィンが共動会であれば他種オレフィンを表明の対象を表現していまた。

### 特開平4-138244(3)

ポリオレフィンが混合されていてもよい。さらに 公知の各種添加剤類、例えば安定剤、充填剤、酸 化防止剤などを添加することもできる。

このような稜層構造のフィルムは、例えば、次のようにして作ることができる。

本発明の油含浸型コンデンサ用フィルムより作 成される油含浸型コンデンサにおいては、その電

融する。一方、エチレン含有量1.0~3.0重量%のエチレンプロピレンランダム共重合体75~88重量%と高密度ポリエチレン12~25重量%を重合させたエチレンプロピレンプロック共重合体を230~270℃にて溶融する。これら2つの溶融ポリマーを1台のTダイより300μm~800μm相当のシート状に押し出し、表面温度50~90℃のチルロールにて冷却固化して積層シートを得る。

この積層シートを130~155℃の温度で長さ方向に4.0~5.6倍延伸し、次いで160~175℃の温度で幅方向に8.0倍~10.5倍延伸し、100~165℃の温度で弛緩しながら熱処理した後、巻取る。

更にこれらのフィルムを100mm幅に截断し、 本発明のコンデンサ用フィルムを得る。

本発明のフィルムを用いて、コンデンサを作る ときは次のようにして行なう。本発明のフィルム 2枚以上を、アルミニウム箱と重ね巻き回し、コ ンデンサ素子を形成する。なお、誘電体層は、上 極は特に限定されるものではなく、例えばアルミニウム、亜鉛、銅、銀、錫、鉛等が使用される。なお、電極の形態は指状でも薫着でもよい。

油含浸型コンデンサに用いる絶縁油としては、電気絶縁性のあるものであれば任意のものであれば任意のものであれば任意のものであれば任意のものである。例えば多塩化ビフェニール系のはかできる。例えば多塩化ビフェニールである。好ましい絶縁にして使用がある。といるは単独で、あるいは混合して使用があることもできる。好ましい絶縁にしてないがない。ないないできる。好ましい絶縁にしてはいかないが、カス吸収性の優れた、フェニルキシリルエタン、モノイソプロピルビフェニールである。

次に本発明の油含浸型コンデンサ用フィルムの製造方法をさらに詳しく説明する。ただし、本発明は以下の製造法に限定されるものではない。

まず、灰分30ppm以下(好ましくは20ppm以下)、アイソタクチック度97.0~99.5%のポリプロピレンを240~280℃にて容

記以外に、他の材料、例えば紙と組み合わせてもよい。次いでこのコンデンサ業子を容器にいれて0~100℃の温度で減圧下にて乾燥を行なう。 乾燥時間は24~48時間ほど実施後、減圧室中の容器に絶縁油、好ましくはフェニルキシリルエタンあるいはモノイソプロピルフェニールを80~100℃の温度で含浸させることによって油含浸型コンデンサが得られる。

次に本発明において採用した例定方法および評 価方法について述べる。

(1)突起の数、突起の高さ、表面粗度Ra JIS-B-0601に準じて測定した。

小板研究所㈱製の解析装置付三次元万能表面形 状制定器Model SE-3FKS を用いてフィルムの表面 を次の測定条件で測定した。

測定長・・・・1 mm

縦倍率・・・5000倍

横倍率・・・200倍

送り速度・・・O、 1 mm/sec

フィルター・・O. 25mm

測定間隔・・・10 μm

測定数・・・・20個

上記条件によって得られた山敷より、高さ 0. 0 1 2 5  $\mu$  m以上の突起の数または高さ 0. 0 2 5  $\mu$  m以上の突起の数を求める。ここでの高さとは、表面凹凸の中心線よりの高さをいう。

#### (2) コンデンサ寿命

10μmのフィルムを3枚重ねて誘電体層とし、電極として6μm厚みのA1 箱を用いて0.2μ Fのコンデンサを作成し、フェニルキシリルエタンを絶縁油に用いて真空下で80℃で24時間免疫を行ない、誘電体層のフィルムに絶縁油を含浸させた油含浸型コンデンサとした。ここでフィルム厚みは10枚重ねのときのマイクロメーター厚みを1枚あたりに換算して求めた。

#### (a) 短期寿命

上記コンデンサを用いて塩温で2.4 k V ・ A C課電し破壊にいたるまでのコンデンサの寿命比較を行なった。

なった。

- コンデンサの端面ずれがなく(端面ずれ1、0mm以下)、A 1 箔の巻き込み折れ皺がない。
- × コンデンサ端面ずれ、折れ數及び抜き とり時層ずれを生じるもの

### . (4)灰分

JIS-C-2111に単じて測定した。

### (実施例)

次に、実施例に基づいて本発明をより具体的に 説明する。

# 実施例1

アイソタクチック度98.8%のポリプロピレンを押出し温度260℃で溶融し、一方エチレン含有量1.5重量%のエチレンプロピレンランダム共重合体83.0重量%と高密度ポリエチレン17.0重量%の配合割合で重合して得られたアイソタクチック度93.5%のエチレンプロピレンプロック共重合体を、押出し温度250℃で溶融し、両方の溶融体を巾660mm、間隙1.0

そして、1200秒以上を

0

- 7 2 0 秒以上 1 2 0 0 秒未満を
- 500秒以上720秒未満を △
- 500秒未満を

#### ×

で表した。

### (b) 長期寿命

上記コンデンサを用いて80℃で1.6kV・ ACを課電し破壊にいたるまでのコンデンサ寿命 比較を行なった。

- 1000hr以上を
- 0
- 600 h r 以上1000 h r 未満を 〇
- 400 h r 以上 600 h r 未満を △
- 4 0 0 h r 未満を

で衷した。

#### (3) 素子卷加工性

10μmのフィルムを3枚重ねて誘電体層とし、電極として6μm厚みのAl箔を用いて0.2μ Fのコンデンサを作成した。コンデンサ作成時の 速度は300m/分で実施し、コンデンサを抜き 取り、平板状にプレス後下記基準により評価を行

mmのTダイより、ポリプロピレン層の厚みが395μm、エチレンプロピレンプロック共宜合体層の厚みが35μmになる様調整して押出し、全厚み430μmのシートを得た。該シートを70℃に加熱されたロールで徐々に固化させた後に、150℃の温度で長さ方向に4.75倍の延伸を行ない、次いで幅方向に168℃の温度で9.0倍延伸し、その後150℃で弛緩処理を行ない巻き取り、本発明のフィルムを得た。なお、製膜速度は230m/分で、得られたフィルムの厚さは10μmであった。

このフィルムを用いて3枚重ねによるコンデンサを作成し、80℃、24時間乾燥し、80℃、24時間乾燥し、80℃、24時間でフェニルキシリルエタンを含浸させた。 得られたコンデンサを10個について短期および 長期寿命を評価した。結果を第1表に示す。

#### 実施例2

冷却固化する際のロール温度を80℃としたほかは、実施例1とまったく同 にしてフィルムを 作成し、評価した。結果を第1表に示す。

# 特閒平4-138244(5)

### 実施例3

冷却固化する際のロール温度を 8 5 ℃としたほかは、実施例1とまったく同様にしてフィルムを作成し、評価した。結果を第1表に示す。

#### 比較例1

冷却固化する際のロール温度を93℃としたほかは、実施例1とまったく同様にしてフィルムを作成し、評価した。結果を第1表に示す。

#### 比較例2

冷却固化するロール温度を30℃とし急冷して シートを得たほかは、実施例1と同様にしてフィ ルムを作成し、評価した。結果を第1表に示す。

#### 比較例3

冷却固化されたシートを145℃の温度で長さ方向に5.0倍延伸したほかは、実施例1と同様にしてフィルムを作成し、評価した。結果を第1 表に示す。

#### 比較例 4

実施例で用いたエチレンプロピレンブロック共 重合体にかえて、エチレン含有量 3.0 食量%の

第1表から、両面が粗面化されたフィルムであって、一方の面は網目構造よりなる粗面であり表面粗度 Raが 0.025  $\mu$  m  $\sim$  0.15  $\mu$  m であり高き 0.0125  $\mu$  m 以上の突起が 10個 $\mu$  m  $\mu$  であり高き 0.05  $\mu$  m  $\mu$  であり高さ 0.05  $\mu$  m  $\mu$  であり高さ 0.025  $\mu$  m 以上の突起が 10個 $\mu$  m  $\mu$  であり高さ 0.025  $\mu$  m 以上の突起が 10個 $\mu$  m  $\mu$  m  $\mu$  をもの、 す

エチレンプロピレンランダム共重合体 8 5 重量 % と高密度ポリエチレン 1 5 重量 % の配合割合で重合して得られたアイソタクチック度 9 2.5 % のエチレンプロピレンブロック共重合体を用い、それ以外は実施例 1 と同様にしてフィルムを作成し、評価した。結果を第 1 表に示す。

### 比較例5

幅方向延伸に際し、175℃の温度で、8.5 倍延伸し、その後弛緩処理を160℃で行なった ほかは、実施例1と同様にしてフィルムを作成し、 評価した。結果を第1表に示す。

#### 比較例6

実施例1で用いたエチレンプロピレンプロック 共重合体に代えてアイソタクチック度97.5% のポリプロピレンを用い、溶融温度を260℃と した他は実施例1と同様にしてフィルムを作成し、 評価した。結果を第1表に示す。

#### 比較例7

実施例1においてエチレンプロピレンブロック 共重合体層をポリプロピレン層の両面に各々摩み

なわち実施例1、実施例2および実施例3は、比較例1~比較例7に比べて、素子卷工程における 臓の発生や製品端部のずれも少なく、コンデンサ 寿命が優れていることが分かる。

# 特開平4-138244()

### 〔発明の効果〕

以上述べたように本発明の油含漫型コンデンサ用フィルムは、表面に粒状突起が形成された粗面と他面は網目構造を有した粗面よりなり、フィルムの滑り性は良好で素子参加工性が優れ、絶縁油の含漫が十分であり、短期および長期寿命並びに絶縁破壊電圧に優れたコンデンサを得ることができる。

特許出願人 東レ株式会社

| Addition | Additio